

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-05-001

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会（2024 年度） ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与人员	线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 5 月 8 日 15：00~17：00
网址	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：邱醒亚先生 独立董事：徐顽强先生 副总经理、董事会秘书：蒋威先生 副总经理、财务负责人：王凯先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	本次业绩说明会采取文字问答方式与投资者进行交流，2024 年度业绩说明会主要内容整理如下： 1、公司本期盈利水平如何？ 回复:尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度实现营业收入 581,732.42 万元、同比增长 8.53%；归属于上市公司股东的净利润-19,828.98 万元、同比下降 193.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,576.85 万元、同比下降 509.87%。感谢您的关注。 2、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 回复:尊敬的投资者，您好！2024 年以来，全球 PCB 行业呈现结构分化的弱复苏态势。根据 Prismark 报告，预计 2024 年产值为 735.65 亿美

元、同比增长 5.8%。从产品结构看，18 层及以上高多层板（同比增长约 40%）、HDI 板（同比增长约 18.8%）是表现最好的细分子行业，主要受 AI、网通、卫星通信拉动，我们判断也是 2025 年表现最好的细分领域。封装基板行业同比增长 0.8%，整体表现为需求不足，行业最差的时候已经过去，2025 年会进一步回暖，BT 载板会比 ABF 载板表现略好。常规多层板市场整体表现为供给过剩、内卷加剧，量增价跌，尤其是国内市场。整体而言行业内公司表现分化，产品结构以高多层板和 HDI 板为主、客户结构以海外为主、面向服务器及周边产品和汽车电动化智能化相关的公司经营表现更好。感谢您的关注。

3、请问公司的 ABF 基板业务目前是否进入到中/大批量生产阶段？

回复:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板目前处于小批量生产阶段。大批量量产的进度主要取决于行业需求恢复状况、客户自身的量产进展及其供应商管理策略。公司正按计划推进市场拓展、客户认证，并不断提升自身技术能力、工艺水平、良率及交付表现，争取早日进入大批量量产阶段。感谢您的关注。

4、当前 ABF 载板产线，主要布局在多少层数，不同层数的产能规划大致是怎样？

回复:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板业务定位于解决高层数、大尺寸、小间距产品的卡脖子难题，已具备 20 层及以下产品的量产能力，20 层及以上产品处于打样阶段。整体产能规模受产品层数和尺寸影响，会有一定差异。感谢您的关注。

5、请介绍国内 ABF 基板生产线情况？贵公司在国内 ABF 生产线占比是多少？随着国内厂商布局 ABF 产线，存在供大于求的情况吗？

回复:尊敬的投资者，您好！目前内资企业中仅深南电路与公司等少数几家企业投资扩产 FCBGA 封装基板，均未进入大批量生产阶段。公司已具备 20 层及以下产品的量产能力，整体良率逐步提升，目前正处于市场拓展阶段。根据 Prismark 报告的预测，FCBGA 封装基板行业 2025 年将回归增长轨道，需求将进一步改善。感谢您的关注。

6、与北美头部客户的合作洽谈到达哪一步了呢？合作的主要产品是什么？

回复:尊敬的投资者，您好！公司与海外头部客户的合作包括 PCB 样板、ATE 半导体测试板业务，目前合作规模占收入比重不高。未来公司会努力拓展与海外头部客户在传统 PCB、高阶 HDI 板、ATE 半导体测试板、CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板等领域的合作。感谢您的关注。

7、前段时间传闻美商务部要求中国台湾 ABF 厂商交出中国大陆客户数据。美国对中国科技的极限施压和无理封锁，对贵司有何影响？

回复:尊敬的投资者，您好！对于部分市场传闻，公司不便置评。从公司自身而言，提升管理能力、研发能力和团队能力，通过优异的产品质量、交付表现和成本优势提升客户满意度，实现公司业务的持续稳健发展，增强股东回报，才是我们最为关注的事情。感谢您的关注。

8、贵司强调 ABF 良率提升至国际一线厂水准。请问公司是如果实现 ABF 良率改善的？在此过程中有没有与国内头部科技企业互相配合协调？

回复:尊敬的投资者，您好！工厂的软硬件能力和团队能力是实现高水准良率的基础。一方面工厂建设已采用先进的设备选型和数字化系统，具备高效率、高可靠度的生产环境；另一方面基于经验丰富的管理团队和行之有效的员工培训、体系建设、工艺能力提升以及严格的管理手段，再辅以长期以来的配方调整和参数优化。感谢您的关注。

9、H 公司推出了 CloudMatrix384，贵司的 ABF 是否有办法帮助其改善性能？

回复:尊敬的投资者，您好！公司 FCBGA 封装基板主要应用于 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等芯片领域，具体的芯片使用场景由客户自主决定。公司层面立足于为客户提供高可靠的服务，通过优异的产品质量、交付表现和成本优势提升客户满意度。感谢您的关注。

10、请问北京兴斐目前是否有进行扩产？进度如何？

回复:尊敬的投资者，您好！北京兴斐 2024 年中已启动产线升级改造项目，更换处理能力及效率更高的关键设备，旨在增加面向 AI 服务器领域如加速卡、高端光模块等产品的产能，把握 AI 时代的行业机会。感谢您的关注。

11、请问公司半导体测试板业务目前的产能和产能利用率如何？

回复:尊敬的投资者，您好！公司 ATE 半导体测试板业务正处于扩产阶段，整体平稳发展，剔除 Harbor 出售影响，2024 年营收同比增长超 30%，毛利率同比提升较大，保持较好的盈利能力和发展势头。良率、准交率和客户满意度持续提升，30 层及以上高阶产品的占比持续增长，季度间接单规模、大客户份额占比和产值规模持续增长，整体发展前景良好。感谢您的关注。

12、请问半导体测试板业务，国内竞争格局如何，主要竞争对手有哪些公司？

回复:尊敬的投资者，您好！半导体测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、多批次、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。根据公开信息，国内 PCB 行业中有涉足半导体测试板业务的公司包括深南电路、沪电股份、明阳电路等。感谢您的关注。

13、公司之后的盈利有什么增长点？

回复:尊敬的投资者，您好！根据 2024 年经营数据，广州科技的 PCB 样板业务和 ATE 半导体测试板业务、北京兴斐 HDI 板和类载板业务、FINELINE 的 PCB 贸易业务经营稳健，处于盈利状态。FCBGA 封装基板业务、CSP 封装基板业务和宜兴硅谷的 PCB 量产业务处于亏损状态。随着公司数字化战略的逐步推进，公司的生产效率和产品质量有望持续提升，产品竞争力得以增强，盈利能力进一步增强；CSP 封装基板业务，随着产能利用率的逐步提升，以及产品结构的升级调整，亏损金额已大幅缩窄，预计扭亏为盈并不会太久；FCBGA 封装基板业务，降本工作初见成效，亏损金额已大幅缩窄。感谢您的关注。

	14、行业以后的发展前景怎样？ 回复:尊敬的投资者，您好！根据 Prismark 报告，预计 2025 年全球 PCB 行业市场规模将达到 785.62 亿美元，同比增长 6.8%，其中，高多层高速板（18 层及以上）、高阶 HDI 板和封装基板预期 2025 年市场规模分别为 34.31、138.16、136.96 亿美元，增长率分别为 41.7%、10.4%、8.7%，高多层高速板和高阶 HDI 板仍维持较高景气度，封装基板市场持续复苏。预计 2029 年全球 PCB 行业市场规模将达到 946.61 亿美元，2024-2029 年复合增长率为 5.2%。其中，高多层高速板（18 层及以上）、高阶 HDI 板和封装基板领域有望实现优于行业的增长速度，预期 2029 年市场规模分别为 50.20、170.37、179.85 亿美元，2024-2029 年复合增长率分别为 15.7%、6.4%、7.4%。感谢您的关注。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 8 日